

# Влияние джоулева разогрева на диффузию магнитного поля в плазму

Егужова М.Ю., Жмайло В.А.,  
Новикова Е.А., Софронов В.Н.  
РФЯЦ ВНИИЭФ, г Саров

# План доклада

# Диффузия магнитного поля в неподвижный плоский слой плазмы с учетом джоулева нагрева и его влияния на коэффициенты диффузии и теплопроводности

## Предположения

- плазма неподвижна, имеет постоянную теплоемкость
- проводимость плазмы – кулоновская  $\sigma(T) \sim T^\alpha$ ,  $\alpha = 3/2$
- зависимость коэффициента теплопроводности от температуры - степенная  $\kappa(T) \sim T^\beta$ ,  $\beta = 5/2$
- решение зависят от одной пространственной координаты

$$\mathbf{H}(x, t) = (0, 0, H_z(x, t)), \mathbf{E}(x, t) = (0, E_y(x, t), 0)$$

В этих предположениях задача сводится к решению уравнений

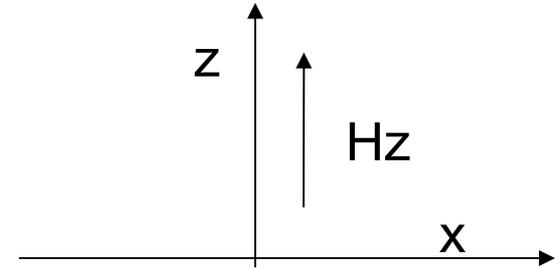
$$\frac{dH_z}{dt} = \frac{\partial}{\partial x} \nu(T) \frac{\partial H_z}{\partial x} \quad \sigma = \sigma_0 \left( \frac{T}{Ry} \right)^{3/2} \quad \nu(T) = \nu_0 \left( \frac{T}{T_0} \right)^{-3/2} \quad \nu_0 = \frac{c^2}{4\pi\sigma_0} \left( \frac{T_0}{Ry} \right)^{3/2}$$

$$\rho C_v \frac{dT}{dt} = \nu(T) \left( \frac{\partial H_z}{\partial x} \right)^2 + \frac{\partial}{\partial x} \kappa(T) \frac{\partial T}{\partial x} \quad \kappa = \kappa_0 \left( \frac{T}{T_0} \right)^{5/2}$$

# Диффузионное размытие контактной границы

Начальные и граничные условия

$$H_z(x, t=0) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ H_0, & x > 0 \end{cases} \quad T(x, t=0) = T_0$$



$$H_z(x \rightarrow -\infty, t) = 0 \quad H_z(x \rightarrow \infty, t) = H_0 \quad T(x \rightarrow \pm\infty, t) = T_0$$

Автомодельное решение, зависящее от переменной  $\xi = x / \sqrt{\nu_0 t}$

Система уравнений

$$\frac{dh}{d\xi} = \varepsilon \tau^\alpha \quad \varepsilon(\xi) = \tau^{-\alpha} \frac{dh}{d\xi} \quad h = \frac{H_z}{H_0}$$

$$\frac{d\tau}{d\xi} = w \tau^{-\beta} \quad w(\xi) = \tau^\beta \frac{d\tau}{d\xi} \quad \tau = \frac{T}{T_0}$$

$$\frac{d\varepsilon}{d\xi} = -\frac{\xi \varepsilon \tau^\alpha}{2} \quad \frac{dw}{d\xi} = -\frac{\xi w \tau^{-\beta}}{2a} - \frac{b^2 \psi^2 \tau^\alpha}{a}$$

Граничные условия

$$h|_{\xi \rightarrow \infty} = 1 \quad h|_{\xi \rightarrow -\infty} = 0 \quad \tau|_{\xi \rightarrow \pm\infty} = 1$$

$$d\tau/d\xi|_{\xi \rightarrow \pm\infty} = 0 \quad dh/d\xi|_{\xi \rightarrow \pm\infty} = 0$$

Решение зависит от двух безразмерных параметров

$$a = \frac{\kappa_0}{\rho C_V \nu_0} \quad b = \frac{H_0}{\sqrt{\rho C_V T_0}}$$

# Диффузионное размытие контактной границы

Решение для линейного варианта  $\alpha = 0$  в отсутствии теплопроводности  $a = 0$

$$h(\xi) = \frac{1}{2} \left( 1 + \operatorname{sign}(\xi) \operatorname{erf} \left( \frac{\xi}{2} \right) \right) \quad \tau(\xi) = 1 - \frac{b^2}{4\pi} \operatorname{Ei} \left( -\frac{\xi^2}{4} \right)$$

Так как  $\operatorname{Ei}(-x) = C + \ln x + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^i x^i}{i \cdot i!}$  то температура в окрестности контактной границы  $\xi^2 \sim 0$  имеет логарифмический профиль

$$\tau(\xi) \sim -\frac{b^2}{4\pi} \ln \xi^2$$

При  $\alpha > 0$  и  $a = 0$  автомодельного решения не существует

Учет теплопроводности устраняет особенность в решении

# Диффузионное размытие контактной границы

Построение автомодельного решения в ограниченной области  $(0 < \xi < \xi_1)$  при учете теплопроводности

Граничные условия на внешней границе  $\xi = \xi_1$  определены с учетом асимптотического поведения функций при  $\xi \rightarrow \infty$

$$h(\xi_1) = \frac{1}{2} \left( 1 + \operatorname{erf} \left( \frac{\xi_1}{2} \right) \right), \quad \tau(\xi_1) = 1,$$

$$\varepsilon(\xi_1) = c_1 \exp \left( -\frac{\xi_1^2}{4} \right), \quad w(\xi_1) = - \left( c_2 + \eta \xi_1 c_1^2 \right) \exp \left( -\frac{\xi_1^2}{2} \right)$$

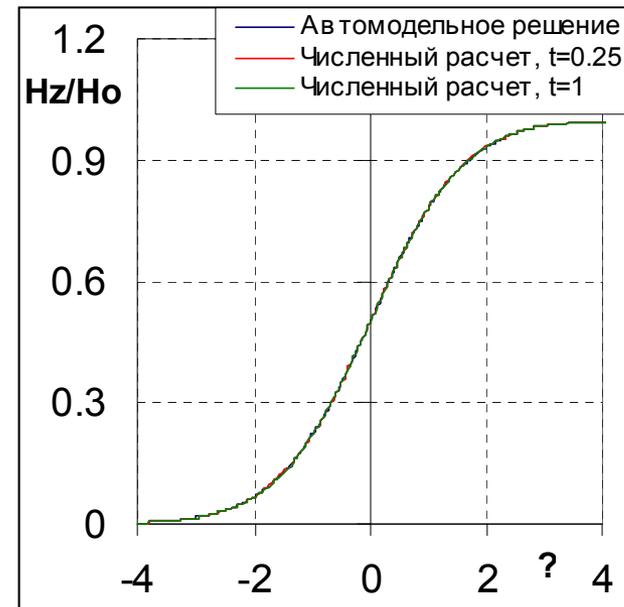
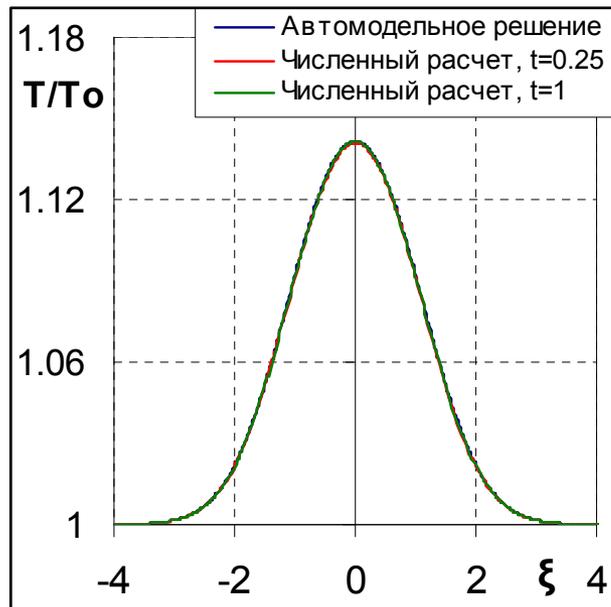
Константы  $c_1, c_2$  выбраны из условия  $h(\xi = 0) = 0.5$   $w(\xi = 0) = 0$

Решение в левой полуплоскости следует из условий симметрии:

$$h(-\xi) = 1 - h(\xi) \quad \tau(-\xi) = \tau(\xi) \quad \varepsilon(-\xi) = \varepsilon(\xi) \quad w(-\xi) = -w(\xi)$$

# Диффузионное размытие контактной границы

Результаты одномерных численных расчетов демонстрируют выход на автомодельный режим. Профили, соответствующие различным моментам времени, совпадают с эталонным решением и между собой

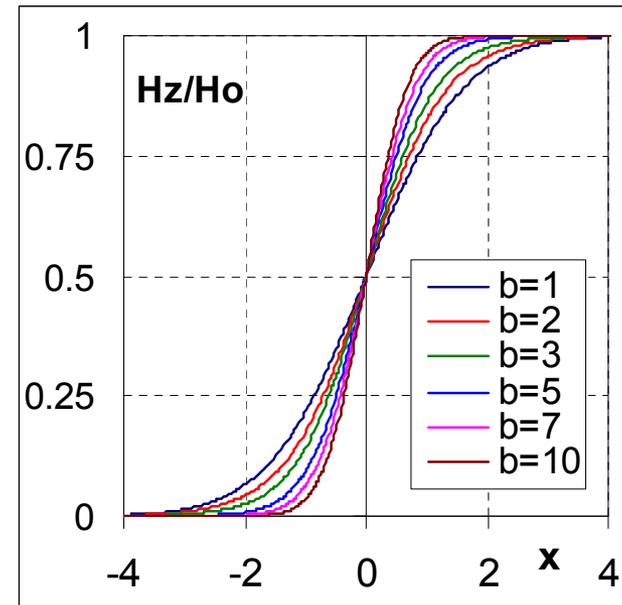
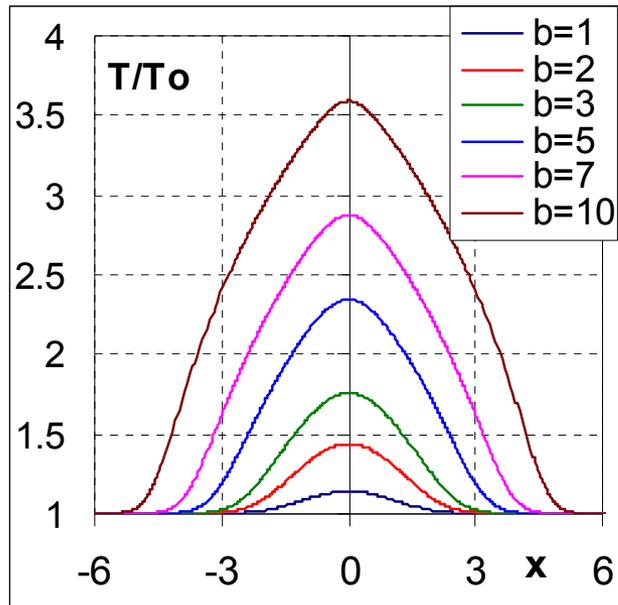


Профили температуры и поперечной компоненты поля для безразмерных параметров  $a = 0.5$ ,  $b = 1$

# Диффузионное размытие контактной границы

Двухпараметрическое множество решений  $a = \frac{\kappa_0}{\rho C_V v_0}$   $b = \frac{H_0}{\sqrt{\rho C_V T_0}}$

При увеличении параметра  $b$  возрастает влияние джоулевого нагрева  
Рост разогрева приводит к замедлению диффузии поля  
Зона размытия уменьшается, а профили поля становятся более крутыми

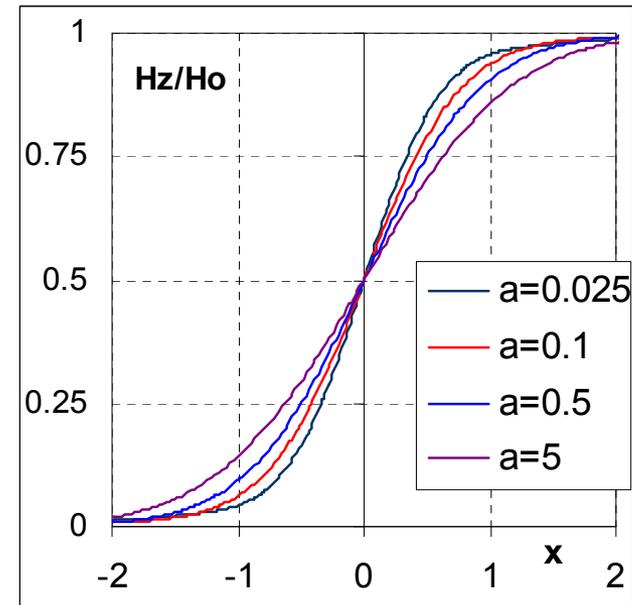
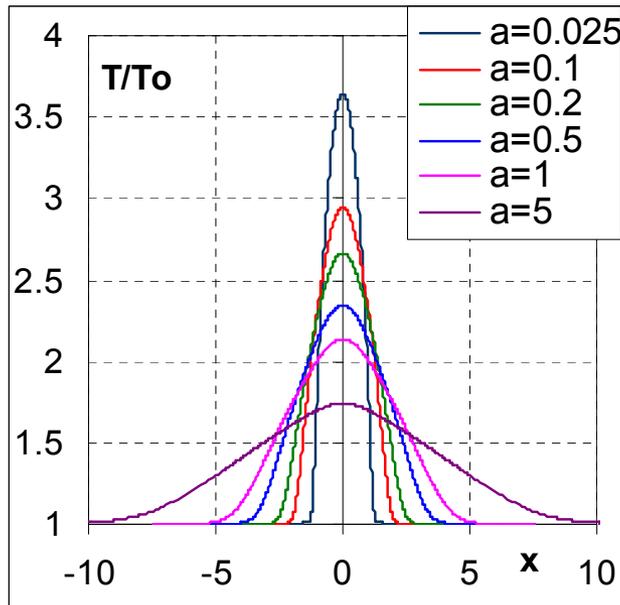


Профили температуры и поперечной компоненты поля при фиксированном значении параметра  $a=0.5$  в момент  $t=1$

# Диффузионное размытие контактной границы

Двухпараметрическое множество решений  $a = \frac{\kappa_0}{\rho C_V v_0}$   $b = \frac{H_0}{\sqrt{\rho C_V T_0}}$

При увеличении параметра  $a$  возрастает роль теплопроводности  
Зона размытия поля стабилизируется  
Тепловая волна обгоняет фронт диффузионной волны.



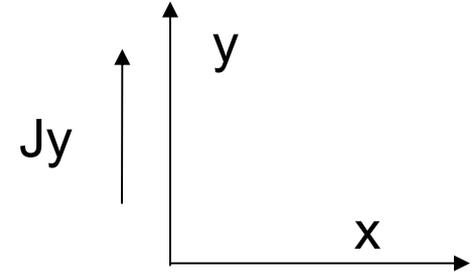
Профили температуры и поперечной компоненты поля при фиксированном значении параметра  $b$  в момент  $t=1$

# Поле поверхностного тока

Начальные и граничные условия

$$H_z(x, t = 0) = 0 \quad T(x, t = 0) = T_0$$

$$J_y(x = 0, t) = \frac{\partial H_z}{\partial x}(x = 0, t) = \frac{J_0}{\sqrt{t}} \quad T(x \rightarrow \infty, t) = T_0 \quad H_z(x \rightarrow \infty, t) = 0$$



Полная энергия системы увеличивается пропорционально  $\sqrt{t}$

$$\Delta E = E(t) - E(0) = 2 \left( \nu(T) H_z \right) \Big|_{x=0} J_0 \sqrt{t} \quad E(t) = \int_0^{\infty} \left( \frac{H_z^2}{2\rho} + C_V T \right) \rho dx$$

Автомодельное решение

$$h(\xi) = H_z / \sqrt{\rho C_V T_0} \quad \tau(\xi) = T / T_0 \quad \xi = x / \sqrt{\nu_0 t}$$

зависит от двух безразмерных параметров

$$a = \frac{\kappa_0}{\rho C_V \nu_0} \quad b = \frac{J_0 \nu_0}{\sqrt{\rho C_V T_0}}$$

## Поле поверхностного тока

Решение для линейного варианта  $\alpha = 0$  в отсутствии теплопроводности  $a = 0$

$$h(\xi) = b\sqrt{\pi} \left( \operatorname{erf} \left( \frac{\xi}{2} \right) - 1 \right) \quad \tau(\xi) = 1 - b^2 \operatorname{Ei} \left( -\frac{\xi^2}{4} \right)$$

Вблизи границы  $\xi^2 \sim 0$  профиль температуры – логарифмический

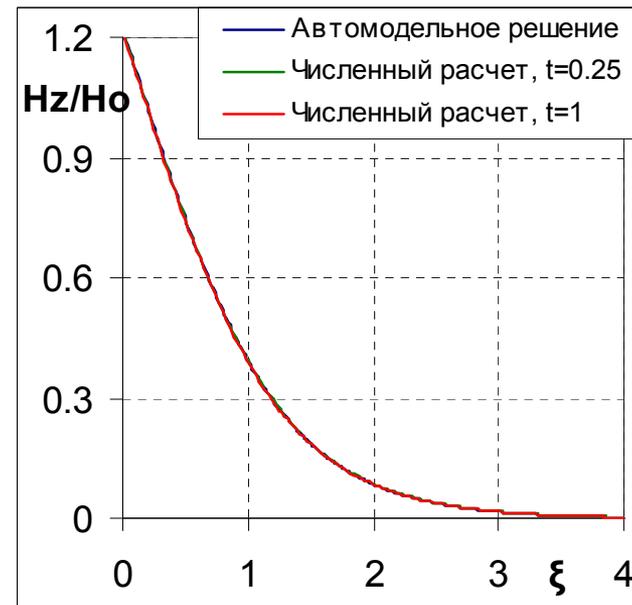
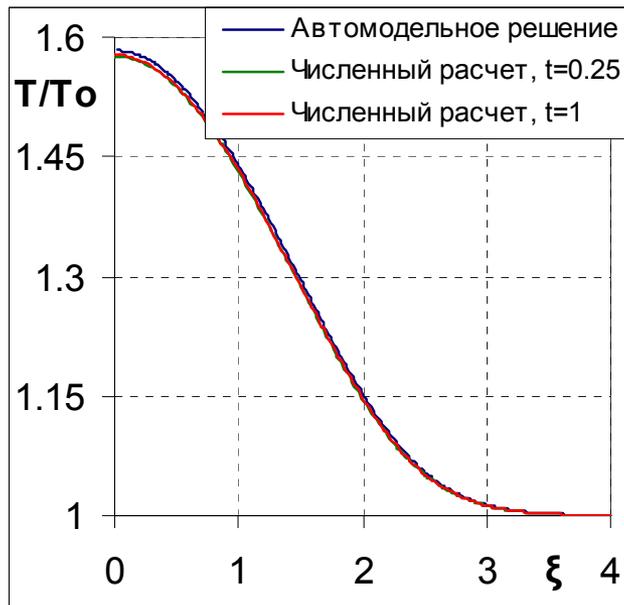
$$\tau(\xi) \sim -b^2 \ln \xi^2$$

При  $\alpha > 0$  и  $a = 0$  автомодельного решения не существует

Учет теплопроводности устраняет особенность в решении

# Поле поверхностного тока

Результаты одномерных численных расчетов демонстрируют выход на автомодельный режим. Профили, соответствующие различным моментам времени, совпадают с эталонным решением и между собой



Профили температуры и поперечной компоненты поля для безразмерных параметров  $a = 0.5$ ,  $b = 1$

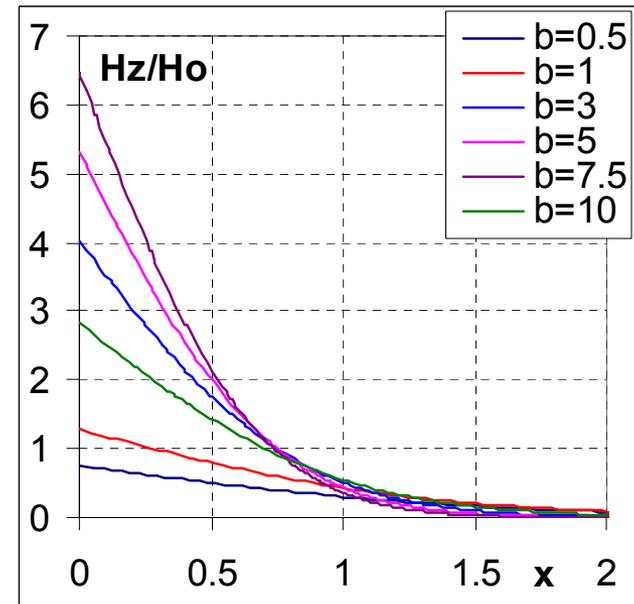
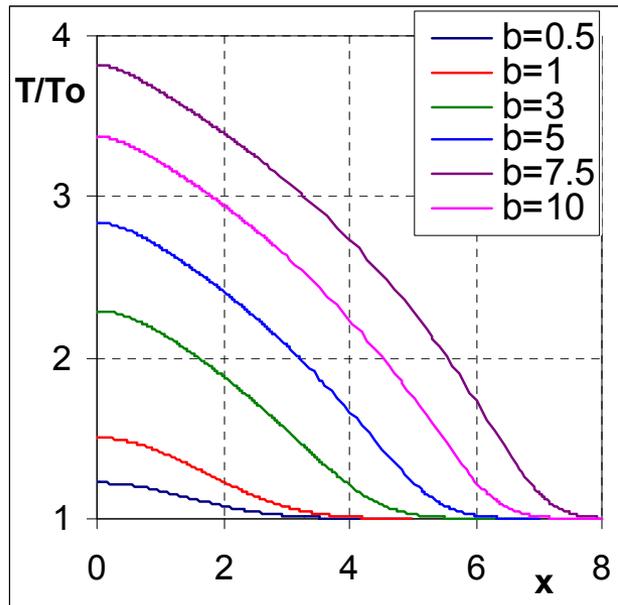
# Поле поверхностного тока

Двухпараметрическое множество решений  $a = \frac{\kappa_0}{\rho C_V v_0}$   $b = \frac{J_0 v_0}{\sqrt{\rho C_V T_0}}$

При увеличении параметра  $b$  возрастает влияние джоулевого нагрева

Рост разогрева приводит к замедлению диффузии поля

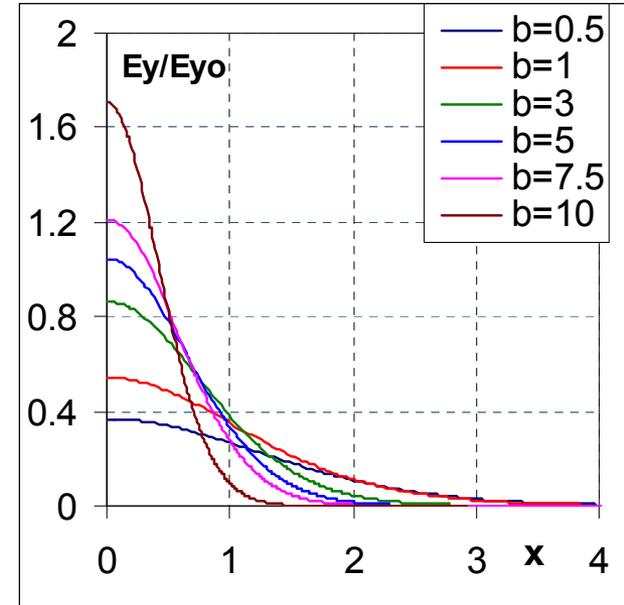
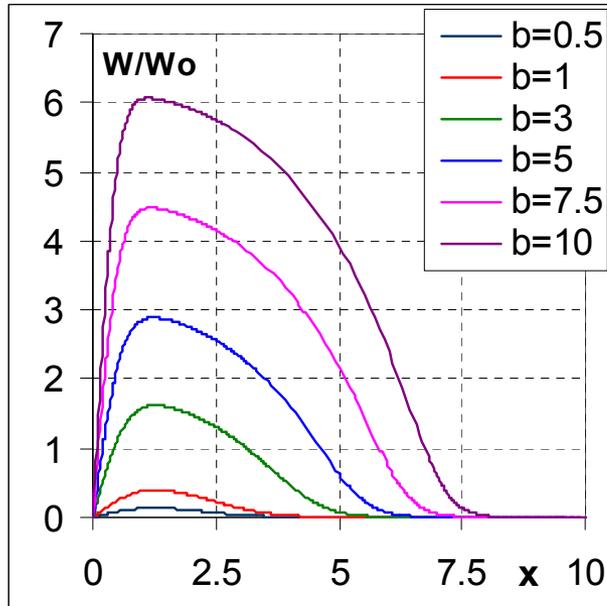
Профили магнитного и электрического полей становятся более крутыми



Профили температуры и поперечной компоненты поля при фиксированном значении параметра  $a=1$  в момент  $t=1$

# Поле поверхностного тока

Двухпараметрическое множество решений  $a = \frac{\kappa_0}{\rho C_v v_0}$   $b = \frac{J_0 v_0}{\sqrt{\rho C_v T_0}}$



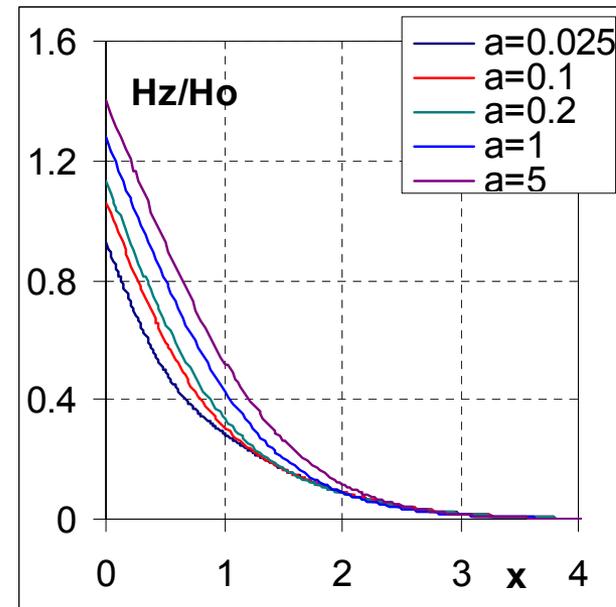
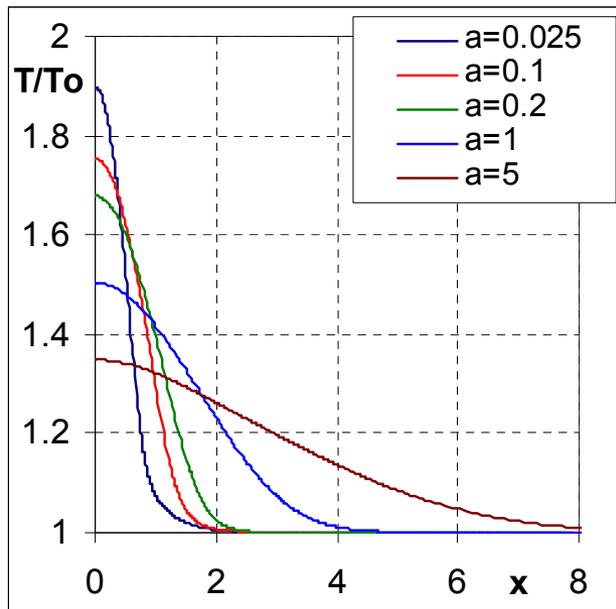
Профили теплового  $W = -\kappa(T) \partial T / \partial x$ ,  $W_0 = \kappa_0 T_0 / \sqrt{v_0 t}$  и магнитного  $E_y = -\nu(T) \partial H_z / \partial x$ ,  $E_{y0} = \sqrt{v_0 \rho C_v T_0 / t}$  потоков при фиксированном значении параметра  $a=1$  в момент  $t=1$

# Поле поверхностного тока

Двухпараметрическое множество решений  $a = \frac{\kappa_0}{\rho C_v v_0}$   $b = \frac{J_0 v_0}{\sqrt{\rho C_v T_0}}$

Параметр  $a$  ответственен за вклад теплопроводности

При его увеличении ширина зоны проникновения поля стабилизируется, что связано с замедлением диффузии.



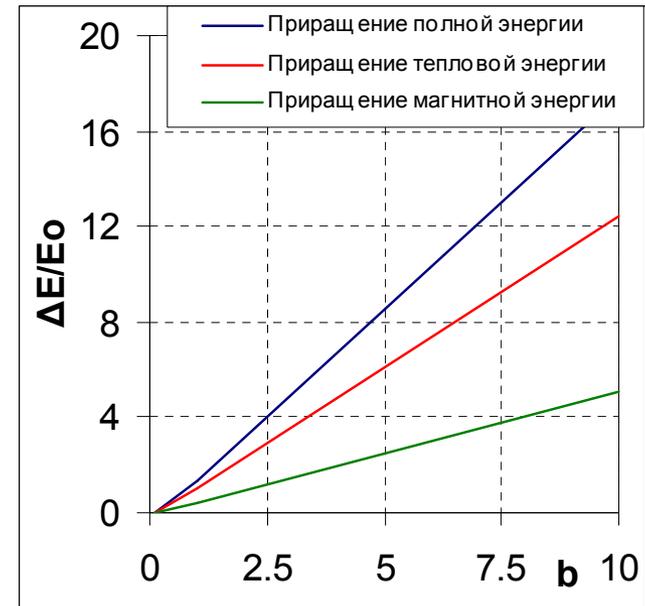
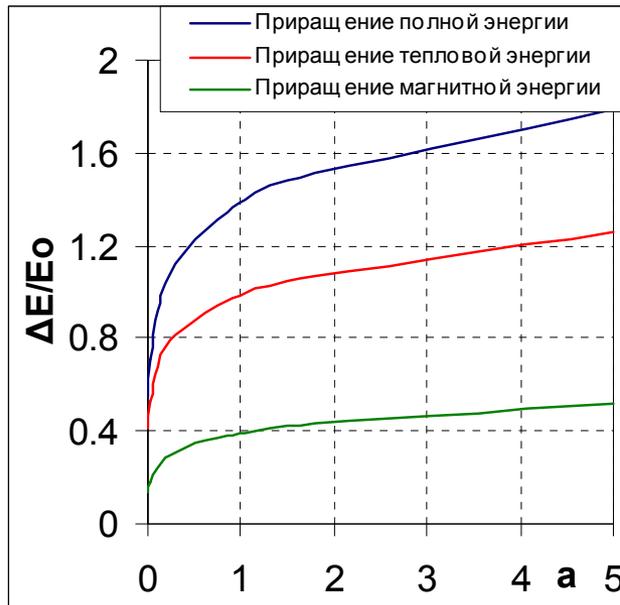
Профили температуры и поперечной компоненты поля при фиксированном значении параметра  $b=5$  в момент  $t=1$

# Поле поверхностного тока

Распределение приращения полной энергии между тепловой и магнитной составляющих

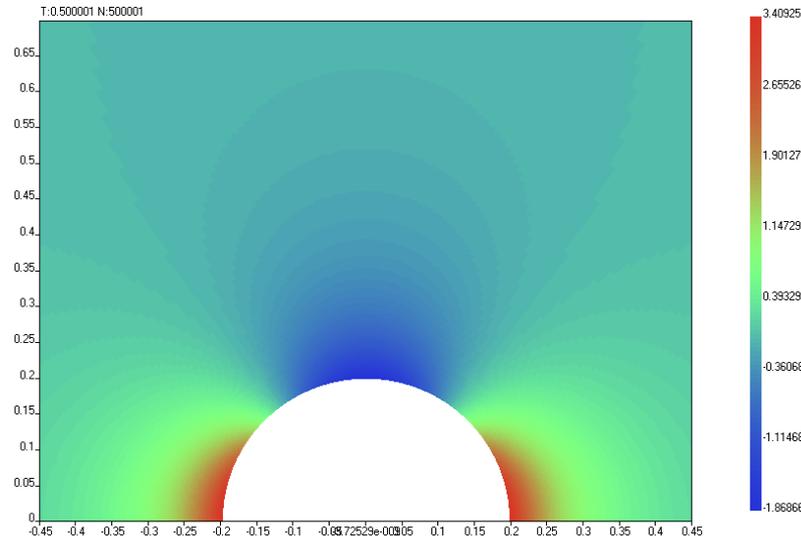
При увеличении параметров  $a$  и  $b$  происходит рост полной энергии и ее составляющих (тепловой и магнитной)

Доля тепловой энергии составляет  $\sim 70\%$ .

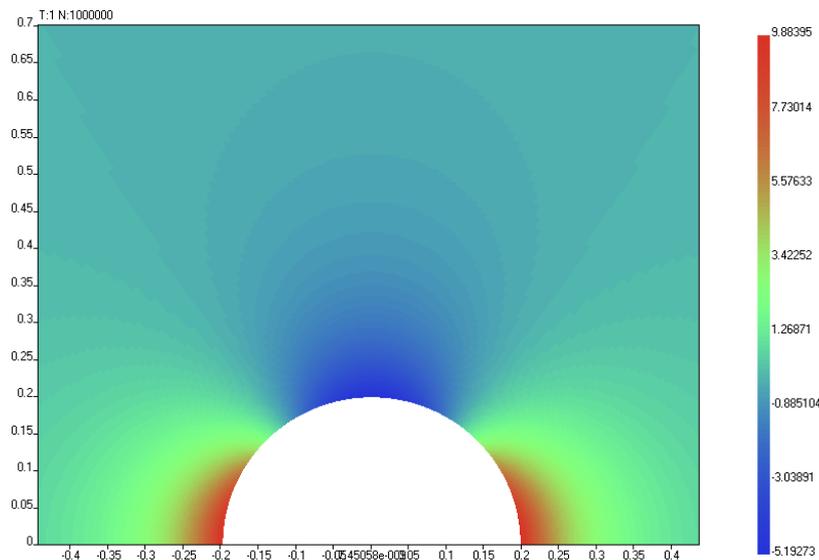


Зависимость приращения полной, тепловой и магнитной энергий от параметров  $a$  и  $b$ .

# Магнитное поле (компонента $H_z$ ) без учета разогрева ( $\nu = 0$ )

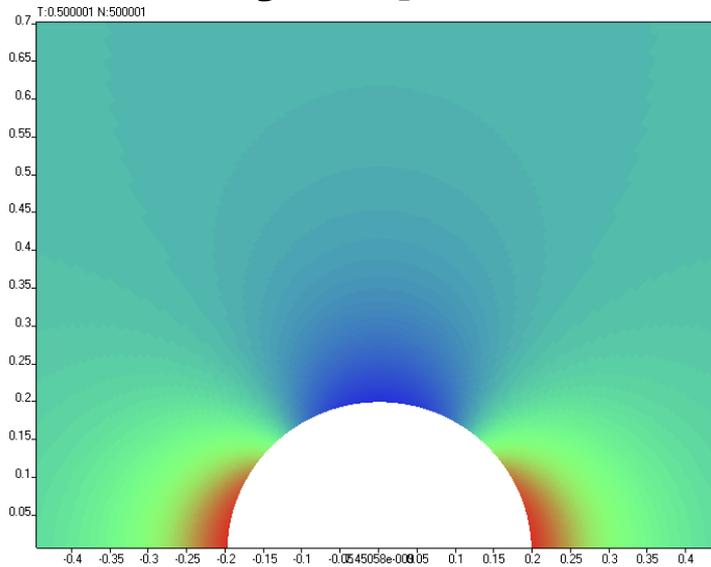


t=0.5

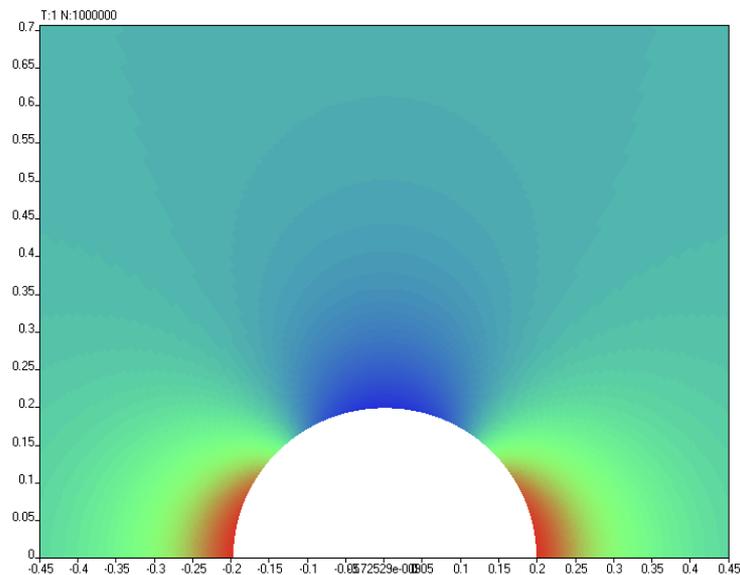


t=1

# Магнитное поле (компонента $H_z$ ) с учетом «умеренного» разогрева ( $\nu = 5$ )

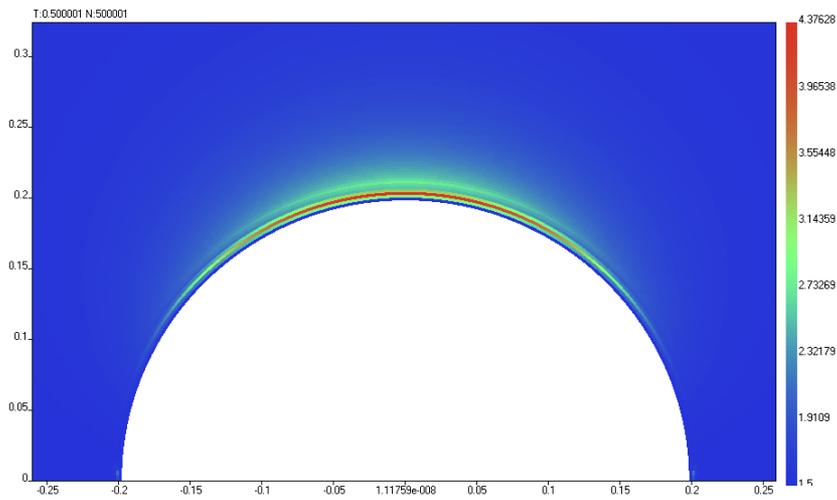


t=0.5

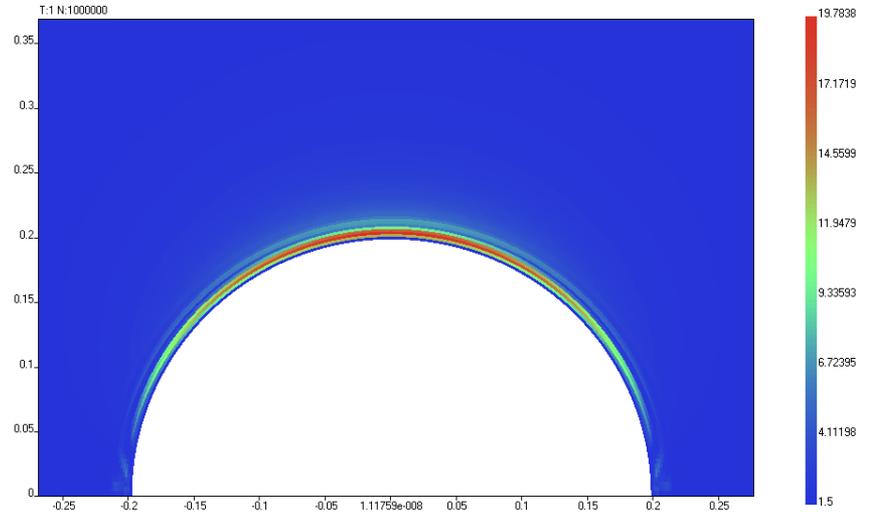


t=1

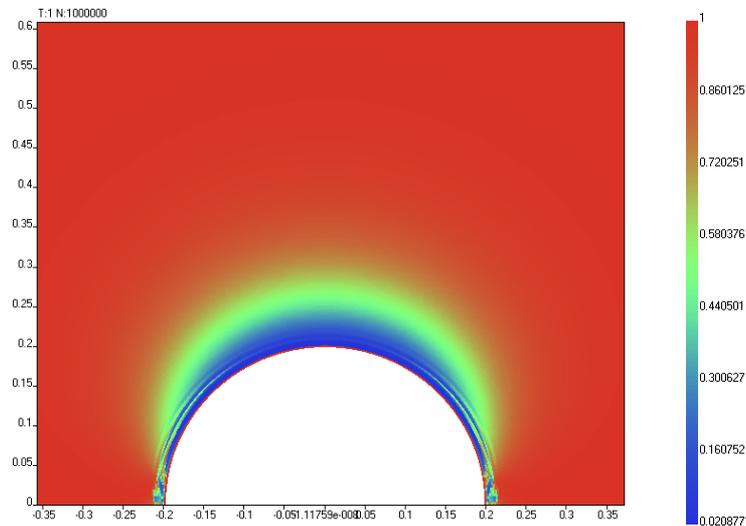
# Энергия плазмы ( $\nu = 5$ )



$t=0.5$

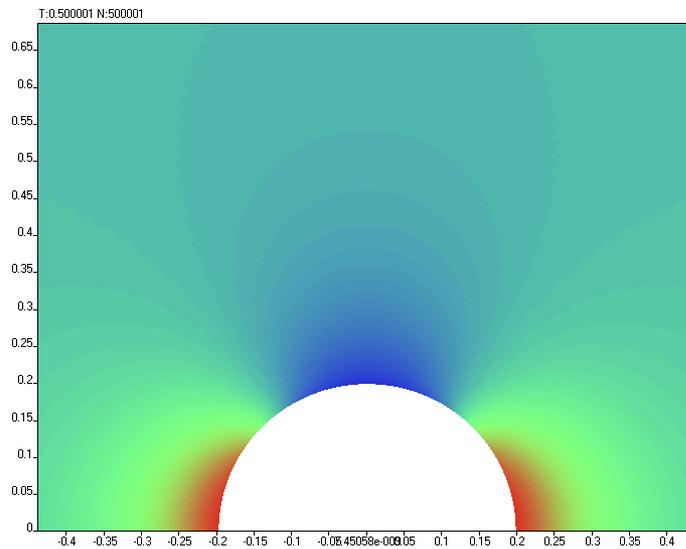


$t=1$

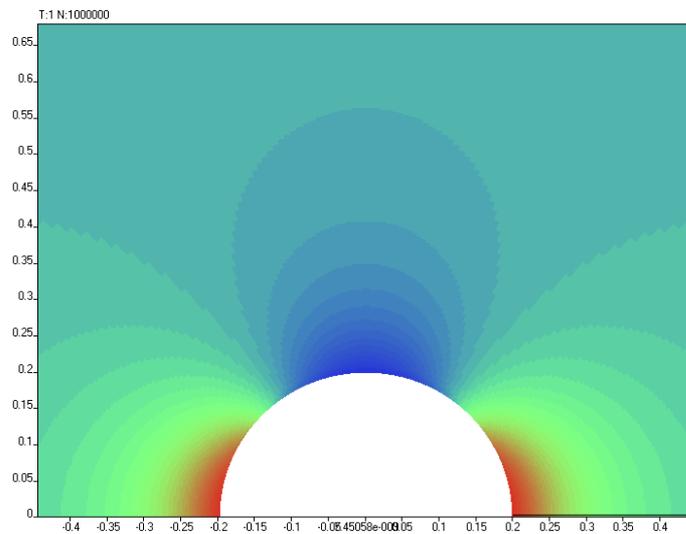


Коэффициент диффузии на момент времени  $t=1$

# Магнитное поле (компонента $H_z$ ) с учетом «сильного» разогрева ( $\nu = 50$ )

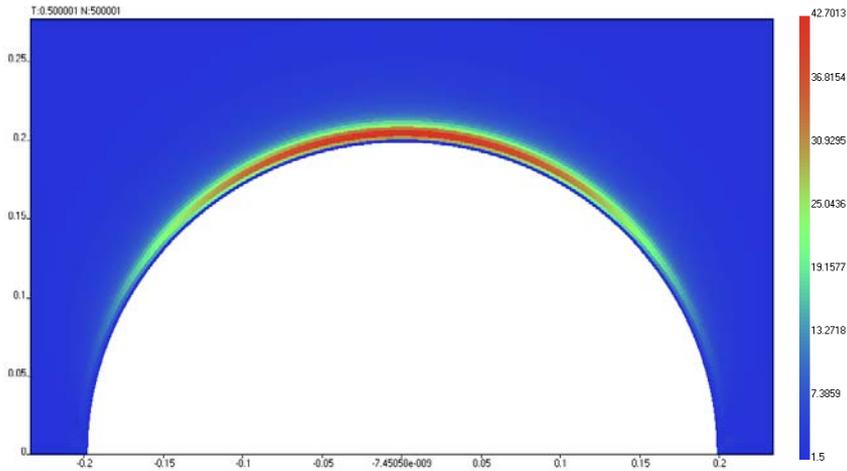


t=0.5

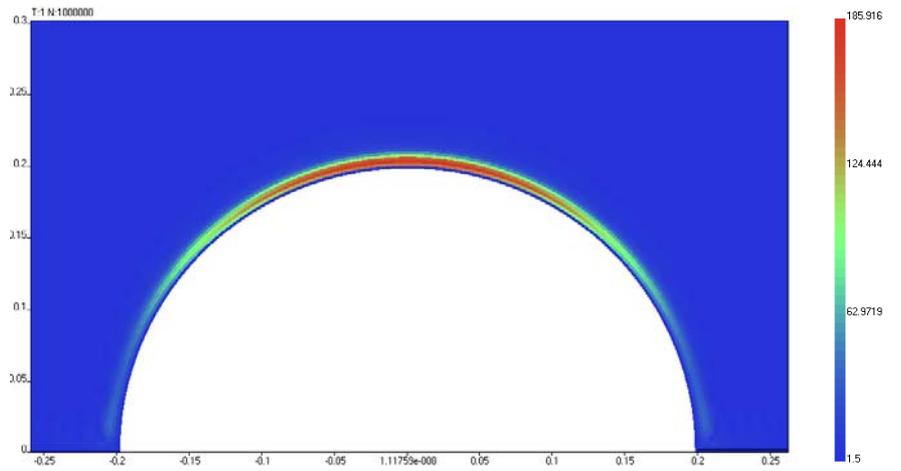


t=1

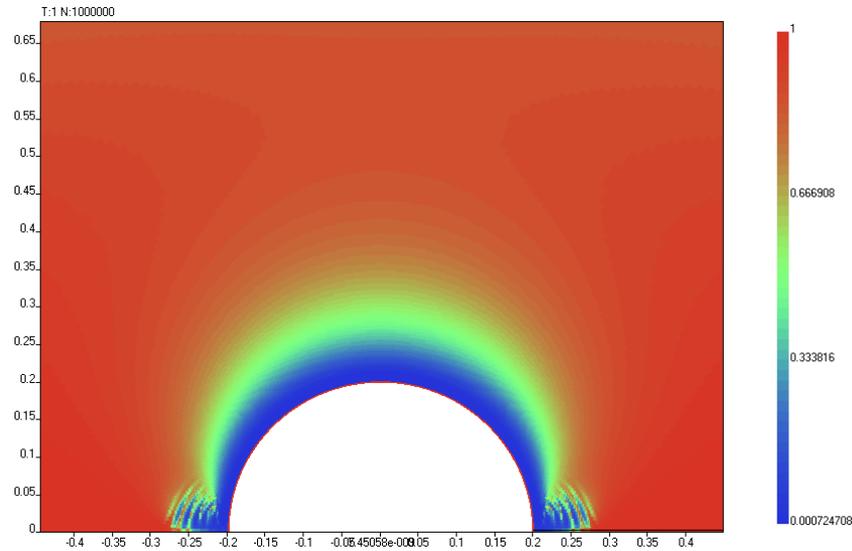
# Энергия плазмы ( $\nu = 50$ )



$t=0.5$

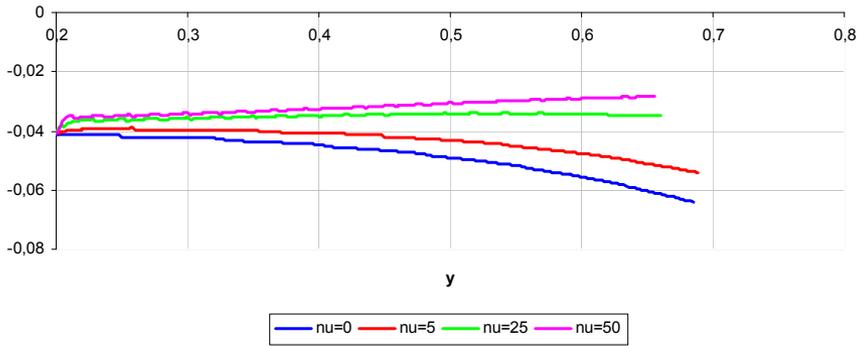


$t=1$

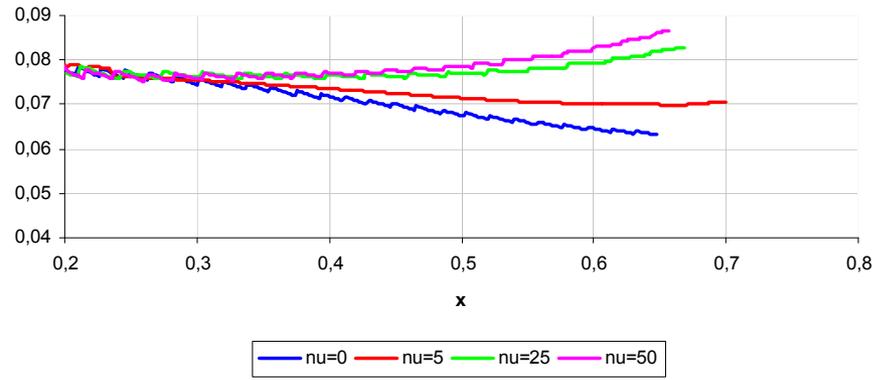


Коэффициент диффузии на момент времени  $t=1$

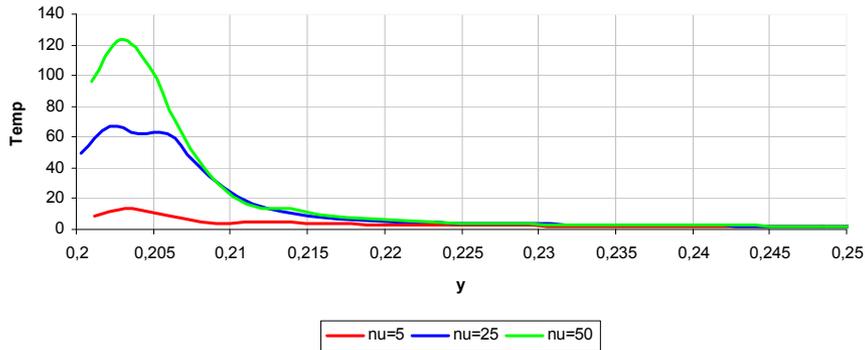
# Результаты расчетов



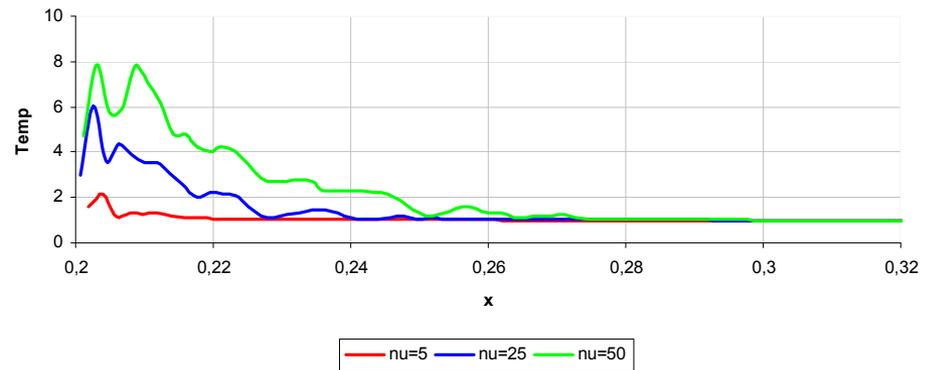
Профили магнитного поля (функция  $H_z \cdot r^3$ ) в экваториальной плоскости диполя при  $t=1$



Профили магнитного поля (функция  $H_z \cdot r^3$ ) вдоль оси симметрии при  $t=1$

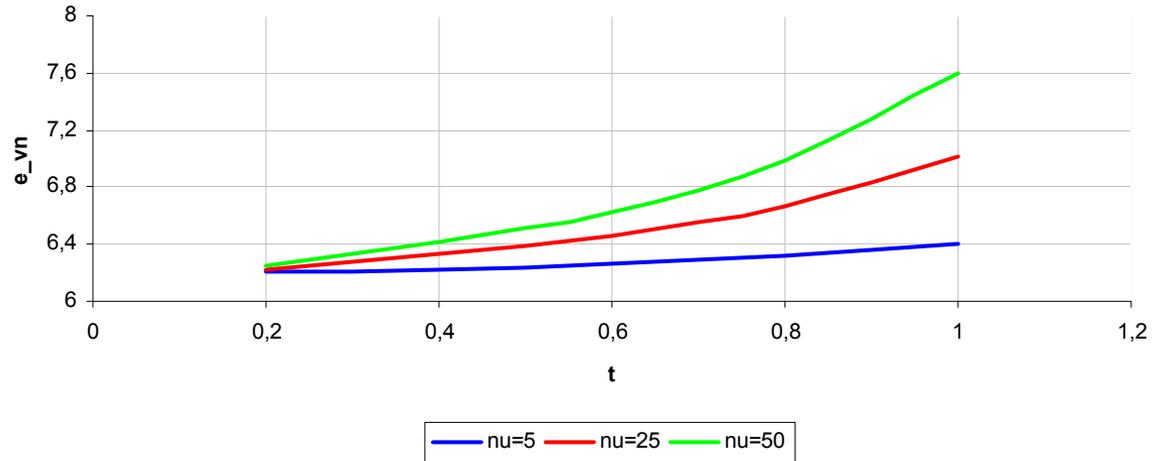


Профили температуры плазмы в экваториальной плоскости диполя при  $t=1$

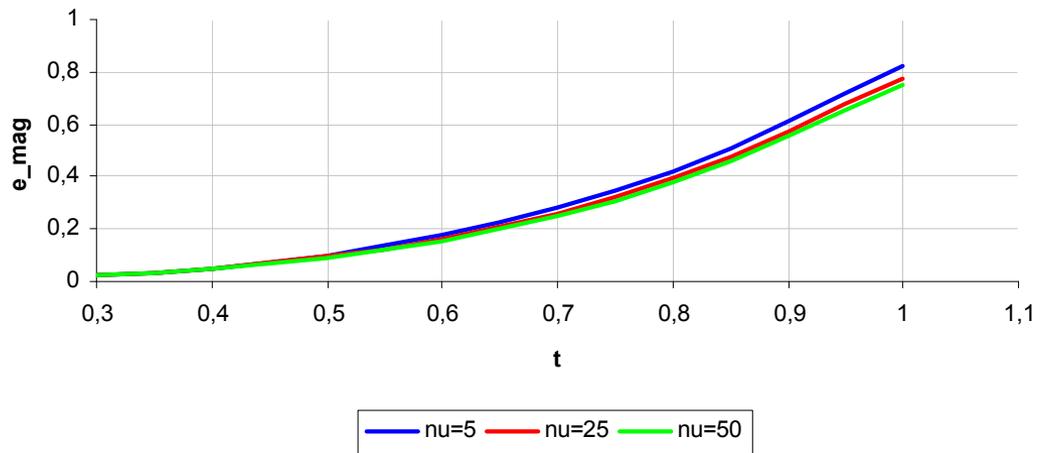


Профили температуры плазмы вдоль оси симметрии при  $t=1$

# Результаты расчетов



Профили внутренней энергии плазмы в зависимости от времени для разных значений  $\nu$



Профили энергии магнитного поля плазмы в зависимости от времени для разных значений  $\nu$

# Заключение

- Показано, что в одномерной задаче в профилях поля на границе может возникать разрыв, а температура обращаться в бесконечность. Показано, что учёт теплопроводности (сколь угодно малой) может устранить некоторые особенности решения.
- Оказывается, что в двумерной задаче влияние разогрева наиболее существенно вблизи экватора. Оно проявляется в замедлении диффузии и укрупнении профилей поля.

$$j_{\varphi}(r) = \begin{cases} j_0 \frac{r}{r_0}, & r < r_0 \\ 0, & r > r_0 \end{cases}$$

$$a(r, s) = \frac{r}{4\sqrt{\pi}} \int_0^s m_z(s') \frac{d\Delta s}{(\Delta s)^{5/2}} e^{(-r^2/4\Delta s)} = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \frac{1}{r^2} \int_{\xi}^{\infty} \xi'^2 e^{-\xi'^2} m_z \left[ s - \left( \frac{r}{2\xi'} \right)^2 \right] d\xi'$$

$$m_z(s) = \mu(s)T(s)$$

$$\mu(s) = \frac{\pi^2}{r_0} \int_0^{r_0(s)} r'^4 dr' \cdot \frac{j_0}{c} = \frac{4\pi r_0^3}{3} \cdot \pi r_0 \cdot \frac{j_0}{c} \cdot \frac{3}{20}$$